



電子部品実装技術委員会 2025年度第1回公開研究会

主催：先進実装・電子部品研究会

◆スペシャル技術公開研究会のご案内

研究会テーマ「レジェンドに学ぼう！ 一実装技術の温故知新一」

捲土重来を期す、半導体や日本のエレクトロニクス業界への励ましとして、是非とも、現役組への応援/激励、引退組へのエールを送っていただければと思います、レジェンドの皆様をお願いいたしました。

[レジェンド定義; 1) 現在存命で、極めて健康、現在も大いに活躍 2) 過去に『偉業』を成し遂げた方]

「頑張れニッポン半導体」、「日米半導体に関わるお話」など、業界での貴重なご経験を聴講できるまたと無い機会になります。

今回、電子部品実装技術委員会が主催し、技術運営委員会が協賛の形で開催にこぎつけました。

奮ってご参加していただきたいと思っております。

開催日時 2025年5月9日(金) 13:45~17:00

開催方式 現地開催 & WEBハイブリッド(Zoom Webinarシステム利用)

開催場所: 回路会館地下1F会議室

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:45~14:00

オープニング 開会挨拶 電子部品実装技術委員会 先進実装・電子部品研究会

14:00~14:50

①「最近の半導体動向と日本の対応」

牧本次生様(元日立製作所取締役専務、元ソニー専務、半導体産業人協会 特別顧問、日本のミスター半導体、レジェンド中のレジェンド)

<概要>

2022年のChatGPT公開を契機として、AI半導体は急速な立ち上がりを示しており、2030年の半導体市場は1兆ドルに達すると予想されている。日本でもTSMC熊本工場の生産が立ち上がり、ラピダスの試作ラインの稼働も始まる。また、市場では自動運転車やロボットなどの新分野が立ち上がりつつあり、半導体分野は活気に満ちている。しかし、長年に渡って右下がりが続いている日本のシェアにはいまだに反転の兆候が見られない。日本は何をなすべきであろうか？

(休憩15分)

15:05~15:55

②「MEMSとともに40年 ~時代と世界を変えたMEMS微細加工技術が半導体実装に寄与~」

神永晋様 (SKグローバルアドバイザーズ株式会社代表取締役、昨年、シリコン深掘り技術の開発と商用化に 対してIEEE Bosch Award受賞)

<概要>

1995年、買収した英国ベンチャー企業STS社にて世界で初めて開発・事業化したシリコン深掘り技術(DRIE)はその後のMEMS: Micro Electro Mechanical Systems(微小電気機械システム)の飛躍的発展のキーテクノロジーとなり、スマートフォンやIoTの世界は、この技術なくしては具現化できなかったと言われていた。10年ほど前から、IoT世界の要となるMEMSセンサとそのネットワーク化による地球規模課題解決の推進活動に参画して来た。半導体プロセスをベースとして発展したMEMSプロセスが、TSVやパッケージングを中心として半導体に寄与しつつある。シリコン深掘り技術により新たに開発されるMEMSが半導体とともに、CASE、MaaS、ロボット、ウェアラブル機器等、新しい世界を切り開いて行くことを念頭に置きながら、グローバルな視点からの事業の推進や開発の経験をお話していただきます。

16:00~16:50

③「日本発信の革新的技術、常温接合」

須賀唯知先生 (明星大学主幹研究員、大阪大学客員教授、東京大学名誉教授 『常温接合』の基盤を確立、現役でご活躍中)

<概要>

かつてexotic processと言われた常温接合は、35年の時を経て、大きな可能性を秘めた手法として育ちつつある。一方では、欧州、中国で日本を凌駕する活動が始まっている。実装とはどうあるべきか、(反省も含めて)これまでの経緯と今後の期待をお話していただきます。

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

電子部品実装技術委員会は、今年度2025年よりこれまでの2つの先進実装研究会とインターコネクション研究会を統合して、先進実装・電子部品研究会として生まれ変わります。(2年前に統合したプリントブル分野もこれまで同様に当研究会で技術調査の研究を推進いたします。)
若手の委員会、研究会メンバーを募集中です。奮ってご応募ください。

参加要項

定員 回路会館地下1F会議室:50名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)
WEB (Zoom Webinar): 100名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円
名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料
非会員一般:10,000円、非会員学生:2,000円、協賛団体会員:5,000円

注意事項(参加方法)

- ① 申込が受理されますと、返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報をご連絡致します。
 - ② ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:クレジットカード決済・コンビニ決済)(手数料学会負担)
 - ③ 領収書(宛名会社名選択可)のご発行は、返信メールのマイページから決済後に即日出力が可能です。
 - ④ WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
 - ⑤ 賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
- * キャンセルポリシー
お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
E-mail: info¥jiep.or.jp (メールアドレスは¥を@に置き換えてください)